

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年7月21日 (21.07.2005)

PCT

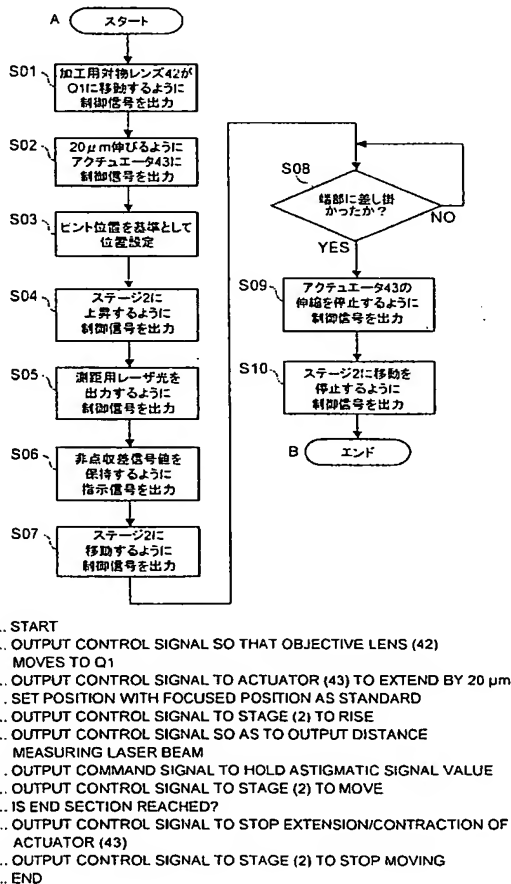
(10) 国際公開番号
WO 2005/065881 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B23K 26/04, 26/38 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018593 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渥美 一弘
(22) 国際出願日: 2004年12月13日 (13.12.2004) (ATSUMI, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 久野 耕司 (KUNO, Koji) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 楠 昌好 (KUSUNOKI, Masayoshi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 鈴木 達也 (SUZUKI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2004-004341 2004年1月9日 (09.01.2004) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP). (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(続葉有)

(54) Title: LASER PROCESSING METHOD AND DEVICE

(54) 発明の名称: レーザ加工方法及びレーザ加工装置



(57) Abstract: Displacement of a laser beam concentration point at an end of an object to be processed is reduced as much as possible, and simultaneously, laser processing is efficiently performed. A laser processing method has displacement acquiring steps (S06-S07) and position setting steps (S08-S09). In the displacement acquiring steps (S06-S07), a second laser beam for measuring the displacement of a main surface of an object to be processed is collected by a lens and irradiated, and the displacement between one point on a planned cutting line of the object and one end is acquired while the beam reflected by the main surface in correspondence with the irradiation is being detected. In the position setting steps (S08-S09), an initial position at which the lens is held relative to the main surface of the object based on the acquired displacement is set and the lens is held at the set initial position. With the lens held at the initial position, a first laser beam for processing is irradiated to form a reformed region at the one end of the planned cutting line, and then, with the lens released from the held state and while the position of the lens being adjusted, a reformed region is formed.

(57) 要約: 加工対象物の端部におけるレーザー光の集光点のずれを極力少なくしつつ効率よくレーザー加工を行うことができるレーザー加工方法を提供する。このレーザー加工方法は、加工対象物の主面の変位を測定する第2のレーザー光をレンズで集光して照射し、当該照射に応じた反射光を検出しながら、過酷対象物の切断予定ライン上の一点から一端の間の変位を取得する変位取得ステップ (S06~S07) と、当該取得した変位に基づいて加工対象物の主面に対してレンズを保持する初期位置を設定し、当該設定した初期位置にレンズを保持する位置設定ステップ (S08~S09) と、を備え、レンズを初期位置に保持した状態で加工用の第1のレーザー光を照射して切断予定ラインの一端部において改質領域を形成した後にレンズを保持した状態を解除してレンズの位置を調整しながら改質領域を形成する。

域を形成する。



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。